2026年11月10日

各　位

会社名　　三井金属株式会社
代表者名　　代表取締役社長 CEO 兼 COO　池信　省爾
（コード番号：5706　東証プライム）
お問合せ先　コーポレートコミュニケーション部長
白石　克巳
（TEL. 03-5437-8028）

マレーシアにおける銅箔新工場建設（固定資産の取得）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり銅箔新工場を建設（固定資産を取得）することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 新工場建設の目的

AI・半導体市場の継続的な急成長が見込まれる中、お客様に対する当社銅箔製品の安定した供給を継続するため。

2. 新工場建設の概要

(1)所在地

マレーシア(当社連結子会社である Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN.BHD.の近傍)

(2)投資の内容

キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」および高周波基板用電解銅箔「VSP™」の製造装置、土地および建屋

（ご参考）上段：新工場生産能力増加数量、下段：新工場増加後の全拠点生産能力

	2031 年度	2032 年度	2033 年度	3ヵ年 生産能力増加 計
MicroThin™ （万㎡/月）	+200 1,000	－ 1,000	+200 1,200	+400
VSP™ （t/月）	+600 2,000	+600 2,600	－ ※2,600	+1,200

※取得予定地は、月産3,600tまで可能（更なる市場拡大に応じて、他拠点と合わせて合計5,000tの生産能力体制を構築する計画も視野に入れております）

(3)投資総額

約1,900億円(うち、土地 約140億円、建屋 約320億円、生産設備他 約1,440億円)

(4)資金調達

自己資金および借入金等により充当する予定です。

(5)稼働時期

2031年4月より順次稼働

3. 今後の見通し

本件による 2027 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微です。なお、2030 年度までの投資および本投資により、機能材料セグメントに含まれる当社銅箔事業の営業利益は、2025 年度比で 2030 年度は 3.2 倍、2033 年度は 5.5 倍となることを想定しており、本投資は 2031 年度以降の増益に寄与する見込みです。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以　上